

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC62HxxxxxDR-G
標準質量: 6 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.724	シリコン	120700	7440-21-3
リードパッド	1.100	ニッケル	183400	7440-02-0
	0.087	銀	14600	7440-22-4
	0.016	金	2700	7440-57-5
ダイアタッチ	0.016	エポキシ樹脂	2700	—
	0.012	溶融シリカ	2000	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.040	金	6700	7440-57-5
封止樹脂	3.604	溶融シリカ	600600	60676-86-0
	0.220	エポキシ樹脂	36700	—
	0.180	フェノール樹脂	30000	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。